



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120626003

2012 年 7 月 3 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA TI-Taiwan サイト製造 ISOxxxx 一部製品 組立部材変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	HPA TI-Taiwan サイト製造 ISOxxxx 一部製品 組立部材変更 現行 : チップ接着剤/モールド樹脂/ボンディングワイア変更 未対応 変更後: チップ接着剤/モールド樹脂/ボンディングワイア変更 対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	10 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) TI-Taiwan(台湾)サイト製造 SOIC/SOICB パッケージ ISOxxxx 一部製品について、供給能力確保の為に、チップ接着剤/モールド樹脂/ボンディングワイアを変更します。部材の変更はグループ毎に下記の通りです。組立サイトの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

チップ接着剤
 モールド樹脂
 ボンディングワイア

現行

変更未対応
 変更未対応
 変更未対応

変更後

変更対応
 変更対応
 変更対応

	組立部材	現行	変更後
Group 1	チップ接着剤	4205694	4209640
	モールド樹脂	4042500	4211470
	ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 Mils, Au	0.96 Mils, Au
Group 2	チップ接着剤	4205694	4209640
	モールド樹脂	4042500	4211470
	ボンディングワイア (径, 部材)	1.31 Mils, Au	0.96 Mils, Au
Group 3	チップ接着剤	4209640	4209640
	モールド樹脂	4042500	4211470
	ボンディングワイア (径, 部材)	0.96 Mils, Au	0.96 Mils, Au

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名 Group 1				
IS01176DW	IS03082DWR	IS0721D	IS07220CD	IS07221CD
IS01176DWG4	IS03082DWRG4	IS0721DG4	IS07220CDG4	IS07221CDG4
IS01176DWR	IS03086DW	IS0721DR	IS07220CDR	IS07221CDR
IS01176DWRG4	IS03086DWG4	IS0721DRG4	IS07220CDRG4	IS07221CDRG4
IS015DW	IS03086DWR	IS0721MD	IS07220MD	IS07221MD
IS015DWG4	IS03086DWRG4	IS0721MDG4	IS07220MDG4	IS07221MDG4
IS015DWR	IS03088DW	IS0721MDR	IS07220MDR	IS07221MDR
IS015DWRG4	IS03088DWG4	IS0721MDRG4	IS07220MDRG4	IS07221MDRG4
IS015MDW	IS03088DWR	IS07220AD	IS07221AD	IS0722D
IS015MDWR	IS03088DWRG4	IS07220ADG4	IS07221ADG4	IS0722DG4
IS03080DW	IS035DW	IS07220ADR	IS07221ADR	IS0722DR
IS03080DWG4	IS035DWG4	IS07220ADRG4	IS07221ADRG4	IS0722DRG4
IS03080DWR	IS035DWR	IS07220BD	IS07221BD	IS0722MD
IS03080DWRG4	IS035DWRG4	IS07220BDG4	IS07221BDG4	IS0722MDR
IS03082DW	IS035MDW	IS07220BDR	IS07221BDR	IS0722MDRG4
IS03082DWG4	IS035MDWR	IS07220BDRG4	IS07221BDRG4	

対象製品名 Group 2				
IS07230ADW	IS07231ADWRG4	IS07240CDW	IS07241ADWG4	IS07242ADWG4
IS07230ADWG4	IS07231CDW	IS07240CDWG4	IS07241ADWR	IS07242ADWR
IS07230ADWR	IS07231CDWG4	IS07240CDWR	IS07241ADWRG4	IS07242ADWRG4
IS07230CDW	IS07231CDWR	IS07240CDWRG4	IS07241CDW	IS07242CDW
IS07230CDWG4	IS07231CDWRG4	IS07240CFDW	IS07241CDWG4	IS07242CDWG4
IS07230CDWR	IS07231MDW	IS07240CFDWG4	IS07241CDWR	IS07242CDWR
IS07230MDW	IS07231MDWR	IS07240CFDWR	IS07241CDWRG4	IS07242CDWRG4
IS07230MDWG4	IS07231MDWRG4	IS07240MDW	IS07241MDW	IS07242MDW
IS07230MDWR	IS07240ADW	IS07240MDWG4	IS07241MDWG4	IS07242MDWG4
IS07231ADW	IS07240ADWG4	IS07240MDWR	IS07241MDWR	IS07242MDWR
IS07231ADWG4	IS07240ADWR	IS07240MDWRG4	IS07241MDWRG4	IS07242MDWRG4
IS07231ADWR	IS07240ADWRG4	IS07241ADW	IS07242ADW	

対象製品名 Group 3			
IS07640FMDW	IS07640FMDWR	IS07641FMDW	IS07641FMDWR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2012 年 3 月 2 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	ISO1050DW	-	-	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOWB/DW/16	
Mount Compound:	4211470	Mold Compound:	4209640	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/Fails	
**Autoclave	121C, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500Cyc		77/0	
Lead Fatigue	22 leads, min. 3 units		22/0	
Lead Pull	22 leads to destruction, min. 3 units		22/0	
Bond Pull	76 Wire, 3 units min		76/0	
Die Shear	-		10/0	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		Approved	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C		Approved	
Notes: ** Tests require preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C				